

Bond MA

Datasheet

Bond MA 是一种热塑性聚酰胺；也就是说，它在经过加热应用后会软化和流动。

粘合说明

Bond MA 通常被用作聚氨酯或聚酯基底的覆盖涂层，以制作粘合性磁线。当热量软化邻匝上的表面涂层并流动到一起时，此类线材将是实现自身粘合。在冷却后，表面涂层会变硬，从而将匝固定到位。涂有 Bond MA 的线材的粘合应被视为可逆的，因为恢复到高温将再次软化涂层。

Bond MA 在 160°C 和 170°C (320-338°F) 之间软化。在 170°C (338°F) 的温度下，一小时后可达到完全粘合强度。延长时间或升高温度可增加导体之间的有效粘合区域，从而适度提高性能。

上述粘合周期是指线材处于高温的时间。烤炉或强制热空气站可能需要额外的时间或更高的温度才能将电磁线提升到所需的粘合温度。

线材的粘合可通过卷绕后的电阻加热完成或通过在烤炉中加热完成。线材的粘合也能在卷绕期间通过应用热气或溶剂(如甲醇)来实现。为了实现最佳效果，卷绕后应在 170°C (338°F) 温度下对这些线圈后烘烤一小时。

粘合性线材的限制

请注意，粘合性磁线在绕组的缝隙中效率低下，只有在相邻的导体密切接触时，它才能很好地粘合。细线和精密卷绕线圈可以最大程度地利用粘合技术。

工作温度

粘合线圈的粘合强度随温度的降低而降低。Bond MA 在 155-165°C (311-329°F) 下将保持室温下粘合强度的大约 5-10%。应该进行服务测试以验证绕线结构和粘合过程的充分性。

Disclaimer: Recommendations are for guidance only, and the suitability of a material for a specific application can be confirmed only when we know the actual service conditions. Continuous development may necessitate changes in technical data without notice. This datasheet is only valid for Alleima materials.